公司代码:688037　　公司简称:芯源微

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	芯源微	688037	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	刘书杰	李辰、宗健腾
电话	024-86889037	024-86889037
办公地址	辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号	辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号
电子信箱	688037@kingsemi.com	688037@kingsemi.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,838,720,219.50	3,496,333,727.06	9.79
归属于上市公司股东的净资产	2,223,327,739.52	2,106,541,950.00	5.54
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	695,601,945.85	504,257,341.67	37.95
归属于上市公司股东的净利润	135,676,104.32	69,406,723.03	95.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,747,458.82	65,782,761.43	57.71
经营活动产生的现金流量净额	-357,432,224.25	111,572,436.08	-420.36
加权平均净资产收益率(%)	6.24	7.43	减少1.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.99	0.82	20.73
稀释每股收益(元/股)	0.99	0.82	20.73
研发投入占营业收入的比例(%)	11.07	8.47	增加2.60个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						12,258
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
沈阳先进制造技术产业有限公司	境内非国有法人	11.57	15,909,156	0	0	无 0
辽宁科发实业有限公司	国有法人	10.48	14,404,574	0	0	无 0
沈阳中科天盛自动化技术有限公司	国有法人	8.48	11,655,000	0	0	无 0
中国科技产业投资管理有限公司	国有法人	1.84	2,523,400	0	0	无 0
周冰冰	境内自然人	1.77	2,426,866	0	0	无 0
宗润福	境内自然人	1.75	2,404,193	0	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-银华集成电路混合型证券投资基金	其他	1.32	1,814,933	0	0	无 0
招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	其他	1.18	1,627,644	0	0	无 0
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.14	1,562,819	0	0	无 0
中国银行股份有限公司-国泰CSI芯半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02	1,407,094	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知沈通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688037　　证券简称:芯源微　　公告编号:2023-061

沈阳芯源微电子设备股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额及到账情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)2335号)同意注册,沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)21,000,000股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币26.97元,应募集资金总额为566,370,000.00元,根据有关规定扣除发行费用60,625,896.22元后,实际募集资金净额为505,744,103.78元。以上募集资金已于2019年12月10日到位,募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具会验字[2019]8294号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]498号),公司于2022年6月向特定对象发行人民币普通股股票8,045,699股,每股面值1元,发行价格为人民币124.29元/股,募集资金总额为人民币999,999,928.71元,扣除不含税的发行费用人民币9,915,093.67元,实际募集资金净额为人民币990,084,835.04元。以上募集资金已于2022年6月8日到位,募集资金到位情况已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具容诚验字[2022]110Z0008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

2023年上半年度,本公司2019年首次公开发行股票募集资金使用情况为:支付银行手续费(不含增值税)1,150.00元,募集资金专用账户利息收入为38,646.28元,募集资金专用账户2023年6月30日余额合计为4,340,833.29元。

单位:人民币元

项目	累计金额
募集资金净额	505,744,103.78
减:截至2023年6月30日直接对募集资金项目投入	387,316,021.56
其中:高端晶圆处理设备产业化项目	248,133,621.56
高端晶圆处理设备研发中心项目	139,182,400.00
减:截至2023年6月30日使用闲置资金永久补充流动资金	76,600,000.00
减:截至2023年6月30日使用闲置资金暂时补充流动资金	190,000,000.00
减:截至2023年6月30日节余募集资金补流	9,284,650.48
加:截至2023年6月30日募集资金理财收益	11,579,663.95
加:截至2023年6月30日利息收入扣除手续费净额	10,217,737.60
加:截至2023年6月30日归还暂时补充流动资金	140,000,000.00
截至2023年6月30日募集资金余额	4,340,833.29

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

2023年上半年度,本公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况为:对募集资金项目投入318,225,227.73元,其中:上海临港研发及产业化项目154,870,436.92元,高端晶圆处理设备产业化项目(二期)637,082.28元,补充流动资金162,717,708.53元。2023年上半年度公司累计使用募集资金318,225,227.73元,支付银行手续费(不含增值税)2,723.32元,募集资金专用账户利息收入为1,964,116.64元,使用暂时闲置募集资金购买理财产品所得投资收益3,851,617.21元,募集资金专用账户2023年6月30日余额合计为60,551,786.11元。具体明细如下:

单位:人民币元

项目	累计金额
募集资金总额	999,999,928.71
减:截至2023年6月30日直接对募集资金项目投入	547,163,208.41 218,843,641.77
其中:临港研发及产业化项目	243,714,078.69
高端晶圆处理设备产业化项目(二期)	637,082.28
补充流动资金项目	302,812,047.44
加:截至2023年6月30日募集资金理财收益	13,788,852.59 13,788,852.59
加:截至2023年6月30日募集资金利息收入扣除手续费净额	4,146,213.22
减:截至2023年6月30日用于现金管理的暂时闲置募集资金	410,220,000.00
截至2023年6月30日募集资金余额	60,551,786.11

二、募集资金管理情况

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,于2019年4月24日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于制定(募集资金管理办法)的议案》。《募集资金管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

1、2019年首次公开发行股票募集资金

公司于2019年12月11日分别在中信银行沈阳和平支行(账号8112901012900643057)、中国建设银行沈阳城内支行(账号21050139000800001255)、招商银行沈阳浑南西路支行(账号124904600110111)开设账户作为募集资金专项账户。2019年12月11日,公司分别与中信银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行、招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行和时任保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年9月8日,公司因2021年年度向特定对象发行A股股票变更保荐机构,与原保荐机构国信证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止,国信证券未完成的持续督导工作由中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)承接。鉴于公司保荐机构已发生更换,为进一步规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定,公司分别与中信银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行、招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行及保荐机构中金公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。截至2023年6月30日,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至2023年6月30日,募集资金专项账户余额情况如下:

单位:人民币元

银行名称	银行账号	余额
中信银行沈阳和平支行	8112901012900643057	已销户
中国建设银行沈阳城内支行	21050139000800001255	422.77
招商银行沈阳浑南西路支行	124904600110111	4,340,410.52
合 计		4,340,833.29

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

2023年上半年度,本公司募集资金使用情况为:支付银行手续费(不含增值税)2,723.32元,募集资金专用账户利息收入为1,964,116.64元,使用暂时闲置募集资金购买理财产品所得投资收益3,851,617.21元,募集资金专用账户2023年6月30日余额合计为60,551,786.11元。具体明细如下:

单位:人民币元

项目	累计金额
募集资金总额	999,999,928.71
减:截至2023年6月30日直接对募集资金项目投入	547,163,208.41 218,843,641.77
其中:临港研发及产业化项目	243,714,078.69
高端晶圆处理设备产业化项目(二期)	637,082.28
补充流动资金项目	302,812,047.44
加:截至2023年6月30日募集资金理财收益	13,788,852.59 13,788,852.59
加:截至2023年6月30日募集资金利息收入扣除手续费净额	4,146,213.22
减:截至2023年6月30日用于现金管理的暂时闲置募集资金	410,220,000.00
截至2023年6月30日募集资金余额	60,551,786.11

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至2023年6月30日,具体使用情况详见附表1:2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2023年6月30日,具体使用情况详见附表2:2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

在2019年首次公开发行股票募集资金到位前,公司使用自筹资金对“高端晶圆处理设备研发中心”募集资金项目累计投入14,034,042.00元,对“高端晶圆处理设备产业化”募集资金项目累计投入389,400.00元,使用自筹资金支付发行费用人民币2,597,169.81元。

公司于2020年4月24日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金17,020,611.81元置换预先投入自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。上述以募集资金置换预先投入自筹资金的情况,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具容诚专字[2020]110Z0064号《关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2020年12月31日,上述自筹资金17,020,611.81元已用募集资金置换完毕。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

在2021年度向特定对象发行A股股票募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为31,738,839.36元,其中对“上海临港研发及产业化”募集资金项目累计投入31,738,839.36元。

公司于2022年8月25日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金31,738,839.36元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。上述以募集资金置换预先投入自筹资金情况,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具容诚专字[2022]110Z0153号《关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2023年6月30日,上述自筹资金31,738,839.36元已用募集资金置换完毕。

(三)对闲置募集资金进行现金管理情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至2023年6月30日,公司使用2019年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的余额为0元,无投资相关产品的情况。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

公司于2022年6月16日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过70,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意意见,保荐机构亦出具了明确的核查意见。

公司于2023年6月9日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过50,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,使用期限自本次董事会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意意见,保荐机构亦出具了明确的核查意见。

截至2023年6月30日,公司使用2021年度向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的余额为41,022万元。

单位:人民币万元

银行	产品名称	类型	金额	购买日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
平安银行沈阳分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG230004402	结构性存款	19,500.00	2023/4/25	2023/7/26	2.85%	否
中信银行沈阳南站支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14886期C23VR01418	结构性存款	21,522.00	2023/4/24	2023/7/24	2.78%	否

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

公司于2020年4月24日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,2020年5月25日,公司召开2019年年度股东大会审议通过了前述议案,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,使用部分超募资金计人民币3,830万元用于永久补充流动资金。

公司于2021年6月11日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,2021年6月28日,公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了前述议案,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,使用部分超募资金计人民币3,830万元用于永久补充流动资金。

截至2023年6月30日,公司累计使用超募资金永久性补充流动资金为7,660万元。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

不适用。

(五)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

公司于2020年7月2日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8,000万元用于暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月,以满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低公司财务成本。截至2021年6月30日,公司已将上述暂时补充流动资金的人民币8,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2021年7月2日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,以满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低公司财务成本。公司在规定期限内实际使用了人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年6月30日,公司已将上述暂时补充流动资金的人民币6,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2022年8月25日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月,以满足公司后续发展的实际需求。公司在规定期限内实际使用了人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币5,000万元。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2023年6月30日,公司暂未使用2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金。

(六)募集资金使用的其他情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

公司于2020年4月24日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意将募集资金投资项目之一“高端晶圆处理设备产业化项目”实施地点由“沈阳市浑南区新岛街6号”变更为“沈阳市浑南区东至沈水一街,南至规划地块,西至沈水大街,北至桃园一路”。上述募投项目实施地点变更不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

公司于2021年3月19日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,同意公司将“高端晶圆处理设备研发中心项目”的达到预定可使用状态时间调整至2022年3月31日,将“高端晶圆处理设备产业化项目”的达到预定可使用状态时间调整至2022年6月30日。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。本次募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定,仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东权益的情形。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

2023年4月17日,公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,将项目实施地点由“辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号”变更至“北至规划路,南至创新路,西至沈水大街,东至沈水一街地块”。上述募投项目实施地点变更不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表1:

2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				50,574.41		本年度投入募集资金总额				0.00	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				38,731.60	
变更用途的募集资金总额比例				不适用							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端晶圆处理设备产业化项目	否	23,860.73	23,860.73	23,860.73	0.00	24,813.36	952.63	103.99(注1)	2022年6月30日	1,611.08	是	否
高端晶圆处理设备研发中心项目	否	13,918.24	13,918.24	13,918.24	0.00	13,918.24	0.00	100.00	2022年3月31日	注2	不适用	否
承诺投资项目合计	—	37,778.97	37,778.97	37,778.97	0.00	38,731.60	952.63	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况		公司于2020年4月24日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意将募集资金投资项目之一“高端晶圆处理设备产业化项目”实施地点由“沈阳市浑南区新岛街6号”变更为“沈阳市浑南区东至沈水一街,南至规划地块,西至沈水大街,北至桃园一路”。上述募投项目实施地点变更不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。										
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		在募集资金到位前,公司使用自筹资金对“高端晶圆处理设备研发中心”募集资金项目累计投入14,034,042.00元,对“高端晶圆处理设备产业化”募集资金项目累计投入389,400.00元,使用自筹资金支付发行费用人民币2,597,169.81元。 公司于2020年4月24日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金17,020,611.81元置换预先投入自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具容诚专字[2020]110Z0064号《关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 截至2020年12月31日,上述自筹资金17,020,611.81元已用募集资金置换完毕。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2020年4月24日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8,000万元用于暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月,以满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低公司财务成本。截至2021年6月30日,公司已将上述暂时补充流动资金的人民币8,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 公司于2021年7月2日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,以满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低公司财务成本。公司在规定期限内实际使用了人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年6月30日,公司已将上述暂时补充流动资金的人民币6,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 公司于2022年8月25日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月,以满足公司后续发展的实际需求。公司在规定期限内实际使用了人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币5,000万元。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元,无投资相关产品的情况。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		公司于2020年4月24日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,2020年5月25日,公司召开2019年年度股东大会审议通过了前述议案,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,使用部分超募资金计人民币3,830万元用于永久补充流动资金。 公司于2021年6月11日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,2021年6月28日,公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了前述议案,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,使用部分超募资金计人民币3,830万元用于永久补充流动资金。 截至2023年6月30日,公司累计使用超募资金永久性补充流动资金为7,660万元。										
募集资金结余的金额及形成原因		“高端晶圆处理设备产业化项目”和“高端晶圆处理设备研发中心项目”结项,节余的募集资金共928.47万元,募集资金节余的主要原因如下: 1、节余的募集资金为公司在没有影响募集资金投资项目建设进度的情况下,利用闲置募集资金进行现金管理产生的投资收益导致。 2、在募投项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理,合理降低项目总支出。										
募集资金其他使用情况		公司于2021年3月19日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司将“高端晶圆处理设备研发中心”募集资金项目累计投入14,034,042.00元,对“高端晶圆处理设备产业化”募集资金项目累计投入389,400.00元,使用自筹资金支付发行费用人民币2,597,169.81元。 公司于2020年4月24日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金17,020,611.81元置换预先投入自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具容诚专字[2020]110Z0064号《关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 截至2020年12月31日,上述自筹资金17,020,611.81元已用募集资金置换完毕。 公司于2020年7月2日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8,000万元用于暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月,以满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低公司财务成本。截至2021年6月30日,公司已将上述暂时补充流动资金的人民币8,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 公司于2021年7月2日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,以满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低公司财务成本。公司在规定期限内实际使用了人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年6月30日,公司已将上述暂时补充流动资金的人民币6,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 公司于2022年8月25日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月,以满足公司后续发展的实际需求。公司在规定期限内实际使用了人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币5,000万元。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元,无投资相关产品的情况。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		公司于2020年4月24日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,2020年5月25日,公司召开2019年年度股东大会审议通过了前述议案,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,使用部分超募资金计人民币3,830万元用于永久补充流动资金。 公司于2021年6月11日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,2021年6月28日,公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了前述议案,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,使用部分超募资金计人民币3,830万元用于永久补充流动资金。 截至2023年6月30日,公司累计使用超募资金永久性补充流动资金为7,660万元。										
募集资金结余的金额及形成原因		“高端晶圆处理设备产业化项目”和“高端晶圆处理设备研发中心项目”结项,节余的募集资金共928.47万元,募集资金节余的主要原因如下: 1、节余的募集资金为公司在没有影响募集资金投资项目建设进度的情况下,利用闲置募集资金进行现金管理产生的投资收益导致。 2、在募投项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理,合理降低项目总支出。										
募集资金其他使用情况		公司于2021年3月19日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司将“高端晶圆处理设备研发中心”募集资金项目累计投入14,034,042.00元,对“高端晶圆处理设备产业化”募集资金项目累计投入389,400.00元,使用自筹资金支付发行费用人民币2,597,169.81元。 公司于2020年4月24日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金17,020,611.81元置换预先投入自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具容诚专字[2020]110Z0064号《关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 截至2020年12月31日,上述自筹资金17,020,611.81元已用募集资金置换完毕。 公司于2020年7月2日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用